



- 광섬유의 제조시 고려사항
  - 굴절률의 분포
  - 코어 및 클래딩의 크기
    - 클래딩의 바깥 직경은 125μm로 표준화
- 광섬유의 제조공정
  - 광섬유의 원자재에 해당하는 프리폼(preform) 제조 단계
  - 프리폼에서 광섬유를 뽑아내는 단계
- 프리폼을 제조하는 단계
  - 프리폼이란?
    - 직경이 10~20cm, 길이는 50~100cm 정도의 투명한 유리며, 원통 구조
    - 광섬유의 코어가 될 부분과 클래딩이 될 부분이 이미 같은 비율로 형성되어 있으며, 굴절률의 분포 역시 동일
  - 내부 증착법: 화합물의 정밀한 조절 가능
  - 외부 증착법: 대형 프리폼 제조에 유리

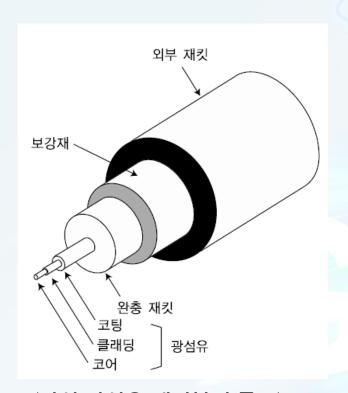


- 프리폼에서 광섬유를 뽑아내는 단계
  - 프리폼이 클수록 광섬유를 많이 뽑아낼 수 있으므로 광섬유의 생산성 향상



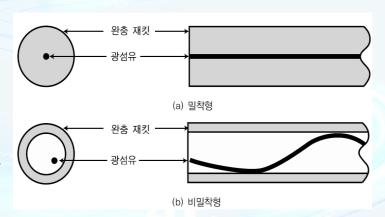
- 광케이블
  - 광섬유를 보호 피복 속에 넣어 외부 환경으로부터 광섬 유를 보호
  - 손쉽게 포설하고, 유지 및 관리하기 위함
  - 설치 위치, 케이블당 광섬유의 수, 케이블의 기계적 견고성 등에 따라 분류
    - » 설치 위치에 따른 분류 : 옥내 케이블, 옥외 케이블, 지중 케이블, 지상 케이블 및 해저 케이블 등
    - » 케이블당 광섬유의 수에 따른 분류: 단심, 2심, 다 심 케이블, 고밀도 다심 케이블 등
  - 광섬유 보호나 설치, 운반 및 유지 보수를 쉽게 할 뿐 아니라 최근에는 무독성, 난연성 및 재활용성 등도 요구되고 있다.

■ 광케이블



〈단심 광섬유 케이블의 구조〉

- 광케이블의 완충 재킷 구조
  - 완충 재킷의 재질은 플라스틱이며 광섬유를
    보호 : 밀착형, 비밀착형 구조
  - 밀착형 구조
    - 외부 환경에 영향을 받기 쉬움
    - 케이블의 소형화에 유리, 유연성과 기계적인 강도가 우수
    - 재료와 공정 비용이 광섬유의 수에 비례하기 때문에, 광섬유의 심선 수가 적을 때 이용
  - 비밀착형 구조
    - 광섬유는 구조적으로 완충 재킷과 결합되어 있지 않으므로, 광범위한 주변 온도의 변화에 영향을 덜 받음
    - 장거리 전송 분야나 임시 설치에 사용



#### ■ 다심 광케이블

- 광케이블의 광섬유 심선 수는 현재와 미래의 사용 가능 성에 의해 결정
- 다심 광케이블은 12심선의 광섬유로부터 수천 심선의 광섬유를 가질 수 있다.
- 다심 광케이블은 주로 옥외나 땅속으로 매설할 경우가 많으므로, 외부 충격에서 광섬유를 보호하는 데 유리한 비밀착형 완충 구조를 많이 사용







#### 단일모드 광섬유의 표준

■ 국제전기통신연합(ITU)의 통신 분야 표준화 부문인 ITU-T가 권고하는 단일모드 광섬유에 대한 표준

ITU-T 권고	광섬유	특징 및 <del>응용</del>
G.652	표준 단일모드 광섬유(standard single-m	1310nm에서 최적화
	ode fiber)	1550nm에서는 분산 보상 필요
G.652.C	저 수분 광섬유(low-water-peak fiber)	E 대역의 손실 피크 제거, CWDM용
G.653	분산 천이 광섬유(dispersion-shifted fiber)	단일 채널용, 잘 사용하지 않음
G.654	차단 파장 천이 광섬유(cutoff-wavelengt	1550nm에서 손실 최소화
	h-shifted fiber)	해저 장거리용
G.655	비영분산 천이 광섬유(nonzero dispersion -shifted fiber)	C대역 WDM용
G.655b	고급 비영분산 천이 광섬유(advanced no nzero dispersion-shifted fiber)	S대역및C대역WDM용

# 광송신기





#### 광송신기

- 광송신기는 정보를 싣고 있는 전기 신호를 광신호로 바꾼 후, 광섬유 안으로 입사시키는 역할
- 광송신기 = 발광소자 + 변조기 + 온도 안정화 회로 등과 같은 주변 회로
- 발광소자는 광통신 시스템에서 가장 가격이 비싼 부품 중 하나며, 발광소자의 특성이 광통신 링크의 최종 특성에 크게 영향을 미침
- 광통신에서 사용되는 발광소자로는 반도체로 제조되는 발광다이오드(LED)와 레이저다이오드(LD)가 있다.

- 반도체로 제조된 LED와 레이저다이오드의 특성
- ▶ 크기가 작아 직경이 작은 광섬유의 코어로 빛을 결합하기 쉽다.
- ▶ 소모 전력이 낮아 주로 집적회로(IC, Integrated Circuits) 로 구성되는 주변 전자 장치와 하나의 패키지로 제조 가능하다.
- ▶ 수명이 길고 신뢰성이 높다.
  - 일반 전자 제품에 사용되는 다른 발광소자와는 달리 광통신에서 사용하는 발광소자는 다음과 같은 사항이 더 고려되어야 한다.
  - ✓ 출력 파장
  - ✓ 출력 스펙트럼 폭
  - ✓ 변조 속도

- 출력 파장
- ▶ 광섬유의 손실 특성을 고려해야 함
  - 파장이 약 1.55μm에서 광섬유의 손실이 최소가 되므로, 현재 장거리 광통신 시스템에서 사용하 는 발광소자의 출력 중심 파장은 1.55μm 근처
  - 반도체로 제조된 LED와 레이저다이오드의 출력 파장은 반도체 에너지 갭  $\Delta E$  에 의해 결정, 즉

$$\lambda[\text{nm}] = \frac{1240}{\Delta E}$$

- LED와 레이저다이오드를 제조하는 데 주로 사용되는 화합물 반도체의 밴드갭 에너지

[화합물 반도체의 밴드갭 에너지와 출력 파장]

화합물	밴드갭 에너지[ev]	출력 파장 범위[nm]
GaAs	1.4	900
InP	1,33	930
GaAlAs	1.4~1.55	800~900
InGaAs	0.95~1.24	1000~1300
InGaAsP	0.73~1.35	900~1700

- 출력 스펙트럼 폭
- ▶ 광섬유의 분산 특성과 함께 고려해야 함
  - 광섬유로 전송되는 광펄스의 퍼짐은 발광소자의
    스펙트럼 폭에 직접 비례
  - 발광소자의 출력 스펙트럼 폭 Δλ가 작을수록 고속 장거리 통신에 유리

참고) 일반적으로 LED의  $\Delta\lambda$ 는 30~120nm에 이르지만, 레이저다이오드의  $\Delta\lambda$ 는1nm 이하로 좁으므로, 고속 장거리 통신에서 LED는 사용되지 않고 주로 레이저다이오드가 사용된다. 레이저다이오드의 스펙트럼 폭은 아주 좁기 때문에 흔히 선폭(linewidth)이라고도 한다.

